

Klebstoffe

Thixotrop / zähelastisch

Produktübersicht und -vergleich



Bezeichnung	Basis-System	Übliche Anwendung	Thixotrop	Autoklavierbar	Vakuumdicht	Schrumpungsarm	Elektrisch leitfähig	Hochtemperaturbeständig	Tieftemperaturbeständig	Chemikalien-/lösungsunmittelresistent	Geringe Wasser-/Dampfaufnahme	Hochhaftend	Flüssigdichtstoff	Farbgebung	Viskosität	Misch.-verh. /Topfzeit	Zugscherfestigkeit	Wärmeformbeständigkeit	Aushärtung
SurABond® 1104-1	2-komponenten Epoxidklebstoff	Für die autoklavierbare Verklebung von optischen Bauteilen, Sensoren und mikroelektronischen Schaltkreisen	x	x	x					x	x	x		Schwarz (bzw. Weiß)	A: 480 Pa·s (0,5 s ⁻¹) A: 150 Pa·s (25 s ⁻¹) B: 6 mPa·s), anorganisch gefüllt	Harz : Härter 1,000 : 0,231 ca. 2 Std.	~ 35 N/mm ²	-40 °C bis +160 °C	Thermischhärtend, 80 °C: 45 min., 90 °C: 30 min.
SurABond®SK 289	1-komponenten Silikonklebstoff	Für die Verklebung von elektrischen und elektronischen Bauteilen sowie für FIPG Anwendungen bzw. als Abdeck-/Schutzlack.	x							x	x		x	Transparent/opak (oder einfärbbar)	0,5 s ⁻¹ : 300 Pa·s, 25 s ⁻¹ : 30 Pa·s	-	~ 9 N/mm ²	-50 °C bis +180 °C	Thermischhärtend (130 °C: 60 min., 150 °C: 10 min.)
SurABond® SK 310	1-komponenten Epoxidklebstoff	Für die Verklebung von mikroelektronischen Bauteilen, insbesondere von solchen, die bei erhöhten Einsatztemperaturen sowie unter Klimabelastungen arbeiten	x					x		x	x	x		Weiß	gefüllt	-	~ 44 N/mm ²	-40 °C bis +250 °C kurzzeitig +300 °C	Thermischhärtend 1 Std. bei 180 °C, alternativ 30 min. bei 200 °C
SurABond® HG 310	-	-												-	-	-	-	-	-